**《電路板產業實習媒合平台》**

**企業申請表**

1. **公司基本資料：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司** | 金像電子股份有限公司 | | | **電話** | | 03-4612541 | | **類型** | ■電路板□化學□材料□設備□其他 |
| **地址** | 桃園市中壢區西園路113號 | | | | | | | **網址** | <https://www.gce.com.tw/index.html> |
| **聯絡人** | 邱寶萱 | **職稱** | 高級管理師 | | **分機** | | 21217 | **Email** | sharon\_chiu@gce.com.tw |

1. **公司招募訊息：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★**公司介紹** | | 金像電子股份有限公司 (GCE) 於1981年創立，在這數十年的經營歷程中一直秉持「品質至上，客戶第一」的原則來服務客戶，隨著全球國際化的趨勢及因應市場需求環境的變遷，除中壢廠外，更斥資設立大陸蘇州廠、常熟廠，將每月生產規模一舉突破百萬平方英尺，並視未來發展計劃，持續擴充產能，以因應客戶之需。  本公司產品主要集中於電腦相關應用(如:伺服器、工作站、筆記型電腦、桌上型電腦等)，近年來年更跨足通訊/網路設備、手機及高電流供應器等其他方面發展，鑑於電子產品變化快速和擁有研發技術即擁有市場的觀念，我們將持續不斷的發展新產品及掌握電子產品流行趨勢，期許在激烈的市場競爭中脫穎而出，成為業界的翹楚。  基於客戶對品質要求及環保意識的抬頭，公司全心投入製程的改善，先後取得ISO-9001，ISO-14001及ISO-45001等國際品質認證，並建立完善的品質系統，確保產品品質符合客戶需求；另一方面也持續提昇客戶服務水平，分別在美國、歐洲、日本、韓國與新加坡等世界各地設立服務據點，就近提供最快速及最好的服務，並蒐集產品未來發展方向，期許能與客戶成為事業發展的夥伴。  綜觀而言，本公司一本「品質至上，客戶第一」的行事原則，不論在產品研發，品質改善，客戶滿意等項目不斷投入心血，確保滿足客戶的需求外，進而強化公司體質，更希望在面對激烈的市場競爭中能夠與客戶攜手合作，實現共同的願景。  企業文化 : 誠信、負責、專業、創新  【金像榮耀，與您共享】  ★數位時代 2021年度高價值企業評選第59名★  ★天下雜誌 2000大製造業排名146名★  ★天下雜誌 韌性企業200強中成長TOP100排名第80名★ |
| **實習階段** | ★薪資 | □時薪：\_\_\_\_\_\_\_ ■月薪： 29,000元起 □其他： |
| ★保險 | ■勞保■健保 □其他保險： |
| ★膳宿 | ■膳食補助：員工餐廳 □住宿補助：\_\_\_\_\_\_ □交通補助：\_\_\_\_\_\_ |
| 其他福利 | 實習後留任享以下福利:   1. 追認實習年資(如實習期滿3個月，自留任後以適用期滿核薪) 2. 留任期滿獎金最高累計10,000元 |
| 其他福利 | 為培育PCB產業新生代人才，金像電子提供優渥『獎助學金』，歡迎在學表現優異同學申請！意者請洽 人力資源部 03-4612541 分機21215、21217 |
| ★給實習生的招募說明 | | 對畢業後的人生感到迷惘嗎  在學校學了很多卻不知能用在哪  誰說實習只能做雜事  金像電子，與你/妳一同成長!  【這份實習經驗可以帶給你/妳什麼】  對於進入金像電子的實習生，我們提供正職水準的薪資待遇，用心的導師制和完善的學習計劃，充實你的實習生活!  我們期待你/妳：  ★活潑熱情有想法★  ★有良好應變能力★  ★願意接受挑戰★  看完以上的介紹，快給自己一個加入金像的機會，  讓金像寫下你/妳學生生涯最豐富的一頁! |
| 未來若成為  正職員工  之其他福利 | | 留任年資累計，視實習表現給予調薪機會，福利比照正職，如下：  ※保險類：勞保、健保、出差平安險、提撥勞退金  ※制度類：夏/冬季制服、緊急協助方案、優秀員工獎勵、資深員工獎勵  ※設備類：福利社、中央空調宿舍、員工餐廳、汽機車停車場  ※休假類：特休/年假、陪產假/產檢假、家庭照顧假、女同仁生理假、育嬰假、主管有薪事假、派外訓練假  ※補助類：員工婚喪喜慶補助、住院慰問、員工急難救助金、生育補助、員工(子女)獎助學金、社團活動補助、研究所在職進修補助  ※獎金/禮品：年終獎金、績效獎金、生產獎金、提案改善獎金、生日禮金(品)  ※訓練類：新人訓、各項職能完整教育訓練(管理領導/專業技術/通識教育/共通職能)、特殊證照課程、派外訓練、數位學習平台  ※員工活動與特惠：新進人員特約醫院免費體檢、在職員工年度健康檢查、福委會優惠團購及特約商店、每月福利社特惠商品、指定店家特惠方案 |

**《電路板產業實習媒合平台》**

**企業申請表**

1. **實習條件申請表：**(1)★為必填(2)本表格若有不足歡迎自行延伸使用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務1** | **實習職務2** | **實習職務3** |
| ★職務名稱 | 製程工程實習生 | 材料工程/技術開發實習生 | 新產品工程實習生 |
| ★職務類型 | □OP □RD ■PE | □OP ■RD □ | □OP □RD ■NPE |
| ★部門(或產線) | 製程工程部 | 材料工程部/技術開發部 | 產品開發部 |
| ★地點(或廠區) | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 |
| ★主要工作  內容描述 | 1.巡視製程作業程序和品質  2.協助品質缺點分析和彙整資料  3.追蹤實驗板進度、品質和彙整資料 | 1.製程專案改善  2.製程異常處理  3.協助新產品開發  4.新產品生產流程設計  5.主管交辦事項 | 1.樣品製作/製程異常排除與製作進度掌控  2.樣品異常改善修正及設計優化調整  3.樣品良率彙整與對策提出  4.作業途程與作業參數測試及驗證 |
| ★實習期間  (可複選) | ■暑期(2022.7~8月)  ■學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) | ■暑期(2022.7~8月)  ■學期(2022.9~2023.1)  □學期(2023.2~2023.6) | ■暑期(2022.7~8月)  ■學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) |
| ★所需人數 | 6人 | 2人 | 1人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 |
| ★加班需求 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 |
| 希望校/系 | 工程/數理化學群(理工科系) | 工程/數理化學群(理工科系) | 工程/數理化學群(理工科系) |
| 英文能力 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 |
| 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等) | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 |
| 其他需要  檢附之資料 | ■履歷 ■成績證明 □其他： | ■履歷 ■成績證明 □其他： | ■履歷 ■成績證明 □其他： |
| ★實習職缺  屬性 | □僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 | ■僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 |
| ★職缺有效  期限 | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務4** | **實習職務5** | **實習職務6** |
| ★職務名稱 | DRC分析實習生 | CAM實習生 | 客服實習生 |
| ★職務類型 | □OP □RD ■設計工程 | □OP □RD ■設計工程 | □OP □RD ■CS |
| ★部門(或產線) | 工程資料設計 | 電腦輔助製造 | 客服部 |
| ★地點(或廠區) | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 |
| ★主要工作  內容描述 | 1.軟體操作 Genesis 與 InCAM Pro  2.Gerber Input  3.執行DRC分析  4.撰寫DRC分析報告  5.預排版設計  6.他廠DRC分析 | 1.電路板線路影像編輯  2.補償及排版  3.製程能力分析及Netlist比對  4.治工具輸出  5.製程改善 | 1.客訴處理  2.廠內外溝通協調能力培養  3.RMA 判定與開立  4.週、月報處理(廠內、客戶端)  5.參與客戶端會議 |
| ★實習期間  (可複選) | □暑期(2022.7~8月)  ■學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) | ■暑期(2022.7~8月)  ■學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) | ■暑期(2022.7~8月)  ■學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) |
| ★所需人數 | 2人 | 1人 | 2人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 |
| ★加班需求 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 |
| 希望校/系 | 工程/數理化學群(理工科系) | 工程/數理化學群(理工科系) | 商管/工程/數理化學群(理工科系尤佳) |
| 英文能力 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 □中等 ■精通 |
| 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等) | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 |
| 其他需要  檢附之資料 | ■履歷 ■成績證明 □其他： | ■履歷 ■成績證明 □其他： | ■履歷 ■成績證明 □其他： |
| ★實習職缺  屬性 | □僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 | ■僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 |
| ★職缺有效  期限 | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務7** | **實習職務8** | **實習職務9** |
| ★職務名稱 | 可靠度實習生 | PQE實習生 | 大數據分析實習生 |
| ★職務類型 | □OP □RD ■QA | □OP □RD ■PQE | □OP □RD ■智慧製造 |
| ★部門(或產線) | 可靠度儀校 | 品質管制部 | 智慧製造整合處 |
| ★地點(或廠區) | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 |
| ★主要工作  內容描述 | 1.執行產品可靠度測試及問題分析  2.可靠度分析報告撰寫與彙整  3.實驗設備操作與維護  4.可靠度分析報告撰寫與彙整 | 1.異常處理  2.統計分析  3.專案進行 | 1.資料收集  2.資料整理  3.資料分析與建模  4.協助模型上線 |
| ★實習期間  (可複選) | □暑期(2022.7~8月)  ■學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) | □暑期(2022.7~8月)  ■學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) | ■暑期(2022.7~8月)  ■學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) |
| ★所需人數 | 2人 | 2人 | 1人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 |
| ★加班需求 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 |
| 希望校/系 | 工程/數理化學群(理工科系) | 工程/數理化學群(理工科系) | 工程/數理化學群(統計系/數學系尤佳) |
| 英文能力 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 |
| 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等) | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 |
| 其他需要  檢附之資料 | ■履歷 ■成績證明 □其他： | ■履歷 ■成績證明 □其他： | ■履歷 ■成績證明 □其他： |
| ★實習職缺  屬性 | □僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 |
| ★職缺有效  期限 | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務10** | **實習職務11** | **實習職務12** |
| ★職務名稱 | 程式開發實習生 | 生產管理實習生 | 測試工程/維修實習生 |
| ★職務類型 | □OP □RD ■IT | □OP □RD ■生管 | □OP □RD ■精修 |
| ★部門(或產線) | 資訊處 | 生產管理部 | 測試工程部 |
| ★地點(或廠區) | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 |
| ★主要工作  內容描述 | 1.使用Fine Report報表工具參與資訊處專案的報表開發。 | 1.生產進度安排  2.QTA 料號之啟動及追蹤  3.客戶訂單OTD管控  4.半成品WIP及成品庫存量管控  5.Surplus 管控 | 1.機台保養/維修(保持穩定稼動)  2.量產TROUBLE SHOOTING  3.重要料號跟催  4.AOI DRT改善  5.SOP/PMP/CHECKLIST制訂  6.設備評估(架線)  7.現場人員教育訓練  8.開發導入新設備 |
| ★實習期間  (可複選) | ■暑期(2022.7~8月)  □學期(2022.9~2023.1)  □學期(2023.2~2023.6) | □暑期(2022.7~8月)  ■學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) | □暑期(2022.7~8月)  □學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) |
| ★所需人數 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 |
| ★加班需求 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 |
| 希望校/系 | 資訊學群 | 商管/工程/數理化學群(理工科系尤佳) | 工程/數理化學群(理工科系) |
| 英文能力 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 |
| 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等) | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 |
| 其他需要  檢附之資料 | ■履歷 ■成績證明 □其他： | ■履歷 ■成績證明 □其他： | ■履歷 ■成績證明 □其他： |
| ★實習職缺  屬性 | ■僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 |
| ★職缺有效  期限 | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) |

|  |  |
| --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務13** |
| ★職務名稱 | 設備維修/廢水處理實習生 |
| ★職務類型 | □OP □RD ■維護 |
| ★部門(或產線) | 維護處 |
| ★地點(或廠區) | 金像電子中壢廠 |
| ★主要工作  內容描述 | 1.PCB設備保養&維修  2.公共&廢水設備保養&維修  3.TPM執行&分析改善  4.PLC程式判讀與編輯  5.環保&工安相關預防工作檢查 |
| ★實習期間  (可複選) | □暑期(2022.7~8月)  □學期(2022.9~2023.1)  ■學期(2023.2~2023.6) |
| ★所需人數 | 3人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少： 40時  (或)每周至少： 5 天 |
| ★加班需求 | □需要□不需要■未定 |
| 希望校/系 | 工程/數理化學群(電機/機械/環工系尤佳) |
| 英文能力 | □略懂 ■中等 □精通 |
| 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等) | □修過電路板學分班  □通過電路板工程師初級  □其他 |
| 其他需要  檢附之資料 | ■履歷 ■成績證明 □其他： |
| ★實習職缺  屬性 | □僅為階段支援 ■期待後續留任  □待評估 |
| ★職缺有效  期限 | □提出申請後3個月內  ■提出申請後3-6個月  □長期性職缺(不限時) |

1. **其他問題與建議：**(歡迎自行填寫)

|  |
| --- |
| **1.以上實習職務媒合後皆需至金像104公告之實習崗位，投遞履歷及相關資料報名**  [**https://www.104.com.tw/company/e7y1qlc?jobsource=checkc**](https://www.104.com.tw/company/e7y1qlc?jobsource=checkc)  **2. 工程師職缺希望校系補充 :**  **(1)學校：國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立政治大學、國立中央大學、國立中興大學、國立中正大學、國立中山大學、國立台灣師範大學、國立台北大學、國立台灣海洋大學、國立彰化師範大學、國立聯合大學、國立高雄大學、國立台灣科技大學、國立台北科技大學、國立高雄科技大學、國立雲林科技大學、國立臺北商業大學、國立台中科技大學、國立虎尾科技大學、國立勤益科技大學、私立中原大學、私立元智大學、私立東海大學、私立逢甲大學、私立長庚大學、私立輔仁大學、私立東吳大學、私立淡江大學、私立中國文化大學、私立台北醫學大學、私立中國醫藥大學。**  **(2)系所：材料、電子、電機、機械、化工、化學、數學、物理、統計等理工相關系所。** |

**TPCA窗口:**03-3815659 曾乙玲#506 [lisa@tpca.org.tw](mailto:lisa@tpca.org.tw) ; 陽浩天#501 [keith@tpca.org.tw](mailto:keith@tpca.org.tw)

1. ★必填**實習計畫書：**(1)一個職務填寫一份表格 (2)本表格若有不足歡迎自行延伸使用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **製程工程實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.巡視製程作業程序和品質  2.協助品質缺點分析和彙整資料  3.追蹤實驗板進度、品質和彙整資料 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一個月 | 1.熟悉環境  2.認識部門主管和職務  3.PCB基礎流程簡介  4.常用系統操作介紹  5.製程進階介紹 | 瞭解工程負責職掌、PCB基礎流程、常用系統操作和製程作業流程 |
| 第二個月 | 1. 製程重要管控項目介紹 2. 製程作業程序和品質缺點 | 瞭解製程重要管控項目和品質缺點認知 |
| 第三個月 | 1. 參與巡視製程作業程序 2. 參與追蹤實驗板進度 | 瞭解製程作業實況 |
| 第四個月 | 1. 巡視製程作業程序 2. 追蹤實驗板進度和彙整品質結果 3. 參與製程品質缺點分布和作業資訊 | 製程品質缺點分析 |
| 第五個月 | 1. 巡視製程作業程序 2. 追蹤實驗板進度和彙整品質結果 3. 參與製程品質缺點分布和作業資訊 4. 實習報告及成果簡報 | 製程品質缺點分析 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.熟悉PCB基礎流程  2.製程品質缺點分析報告  3.實驗板品質結果報告 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(2)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **材料工程&技術開發實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.製程專案改善  2.製程異常處理  3.協助新產品開發  4.新產品生產流程設計  5.主管交辦事項 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一/二週  (7/4~7/15) | 1.介紹環境與認識資安  2.認識公司部門組織與處內工作職掌  3.認識傳統印刷電路板流程 | 瞭解公司組織、工作職掌及基礎PCB流程 |
| 第三/四週  (7/18~7/29) | 1.學習與工作職掌相關之製程  2.認識與工作職掌相關之部門功能 | 每日提出學習日誌 |
| 第五/六週  (8/1~8/12) | 1.學習工作職掌之品質/工單/電子文件系統  2.利用公司網站學習PCB相關資訊  3.與導師討論訂定專案題目 | 每日提出學習日誌 |
| 第七/八週  (8/15~8/26) | 1.確認並開始執行改善專案  2.學習專案計畫  3.學習簡報製作 | 每日提出學習日誌  提出專案簡報進度 |
| 第三月  (8/29~9/30) | 1.學習專案分析/資料收集  2.學習改善對策制定 | 每日提出學習日誌  提出專案簡報進度 |
| 第四月  (10/3~10/31) | 1.學習與確認執行對策是否正確  2.學習獨立思考與眾人討論之能力 | 每日提出學習日誌  提出專案簡報進度 |
| 第五月  (11/1~11/30) | 1.確認執行對策是否有效  2.學習尋找相關改善對策能力 | 每日提出學習日誌  提出專案簡報進度 |
| 第六月  (12/1~12/30) | 1.簡報資料歸納  2.學習上台報告能力 | 提出專案簡報初稿 |
| 第七月  (1/3~1/20) | 1.提出簡報並報告  2.學習”當責”精神 | 提出完整專案簡報  學習”當責”精神 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.認知傳統印刷電路板作業流程  2.可獨立執行專案能力  3.獨立完成工作簡報 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **新產品工程實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.樣品製作時,製程異常時排除與製作進度掌控  2.樣品異常時改善修正及設計優化調整  3.樣品良率彙整與對策提出  4.作業途程與作業參數測試及驗證 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一個月 | 1.認識環境  2.認識金像製程  3.認識部門主管 | 瞭解金像組織及PCB基礎流程 |
| 第二個月 | 1.製程簡介學習(一)  2.製程異常處置(一)  3.工單系統/WIP系統操作 | 1.製程熟悉度  2.異常處置回報  2.系統操作 |
| 第三個月 | 1.製程簡介學習(二)  2.製程異常處置(二)  3.MECN及VALOA系統操作 | 1.製程熟悉度  2.異常處置回報  2.MECN發行 |
| 第四個月 | 1.板面檢驗流程學習  2.板面異常WAIVE處置  3.品質檢驗及WAIVE系統操作 | 1.製程熟悉度  2.異常處置回報  3.WAIVE單建立 |
| 第五個月 | 1.發料規則說明及操作  2.結案報告撰寫  3.學習成效與心得分享 | 1.發料系統維護  2.報告發行  3.心得發表 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.重點製程異常自行排除  2.異常問題分析確認及對策提出與發文修正  3.製作資料匯整及交接 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(4)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **D**  **R**  **C**  **分析實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.軟體操作 Genesis 與 InCAM Pro  2.Gerber Input  3.執行DRC分析  4.撰寫DRC分析報告  5.預排版設計  6.他廠DRC分析 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週  (9/5~9/8) | 1.熟悉環境  2.認識設計工程處  3.認識部門主管 | 瞭解設計工程處組織及部門作業流程 |
| 第二週  (9/12~9/16) | 1.Genesis 與 InCAM Pro 操作  2.料號命名原則 | CAM 編輯軟體操作 |
| 第三週  (9/19~9/23) | 1.GERBER Import 方式與操作練習  2.GERBER 屬性判斷  3.層別命名方式 | 廠內層別命名方式 |
| 第四週  (9/26~9/30) | 1.DRC分析- DRC1/DRC2 的分析操作與異常處理 | 學會 DRC 1/ DRC 2 的分析與系統異常處理方式 |
| 第五週  (10/3~10/7) | 1.DRC其餘分析操作與異常處理 | 學會DRC 其他分析 |
| 第六週  (10/11~10/14) | 1.DRC報告內容說明與填寫-鑽孔/防焊 | 解說鑽孔/防焊的報告內容與如何找出客戶設計的問題點 |
| 第七週  (10/17~10/21) | 1.DRC報告內容說明與填寫-內層 | 解說內層的報告內容與如何找出客戶設計的問題點 |
| 第八週  (10/24~10/28) | 1.DRC報告內容說明與填寫-外層 | 解說外層的報告內容與如何找出客戶設計的問題點 |
| 第九週  (10/31~11/4) | 1.DRC報告內容說明與填寫-文字與其他特殊事項 | 解說文字與特殊事項的報告內容與如何找出客戶設計的問題點 |
| 第十週 (1/7~11/11) | 1.InCAM Pro的DRC分析方式 | 少部分功能必須使用 InCAM Pro，學會 InCAM Pro 分析 |
| 第十一週 (11/14~11/18) | 1.客戶Net Compare 與分析 | 如何比對客戶提供的 NET 與 GERBER 設計是否一致，若有不符，如何找出GERBER 設計的問題處 |
| 第十二週 (11/21~11/25) | 1.預排版教學  2.他廠 DRC 分析的差異與判斷方式 | 藉由預排版功能，讓 OP 設計結構能更符合客戶要求  代工其他廠 DRC 注意事項 |
| 第十三週 (11/28~12/2) | 1.實際操作練習 | 操作練習 |
| 第十四週  (12/5~12/9) | 1.成效驗收，結訓心得報告 | 完成訓練驗收 |
| 第十五週起  (12/12~12/30) | 上線作業 | 執行DRC分析任務 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.具備InCAM Pro及Genesis 2000之DRC軟體操作能力  2.完成一般料號及HDI/ sequential料號之Gerber Input  3.完成一般料號及HDI/ sequential料號之DRC分析  4.完成一般料號及HDI/ sequential料號之DRC分析報告 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(5)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **C**  **A**  **M實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.電路板線路影像編輯  2.補償及排版  3.製程能力分析及Netlist比對  4.治工具輸出  5.製程改善 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週  (7/4~7/8) | PCB製程簡介及底片製作原理 | 內層作業流程考試 |
| 第二週  (7/11~7/15) | PCB製程簡介及底片製作原理 | 鑽孔,雷射,背鑽考試 |
| 第三週  (7/18~7/22) | PCB製程簡介及底片製作原理 | 外層作業流程考試 |
| 第四週  (7/25~7/29) | PCB製程簡介及底片製作原理 | 防焊文字作業流程考試 |
| 第五週  (8/1~8/5) | Genesis基本操作 | 阻抗coupon layout |
| 第六週  (8/8~8/12) | 鑽孔, Laser, 背鑽製作 | 程式帶製作及輸出 |
| 第七週  (8/15~8/19) | 底片補償 | 內層線路及GND補償 |
| 第八週  (8/22~8/26) | Panel 排版 | 內層底片排版輸出 |
| 第九週  (8/29~9/2) | 學習心得及Q&A | 學習心得報告 |
| 第一月  (9/2~9/30) | 內層底片編輯實做 | 產出內層工作稿 |
| 第二月 (10/1~10/31) | 內層底片編輯實做 | 產出內層工作稿 |
| 第三月 (11/1~11/30) | 鑽孔程式編輯輸出 | 產出鑽孔程式 |
| 第四月 (12/1~12/31) | 背鑽, Laser, 塞孔片製作 | 產出背鑽, Laser, 塞孔片 |
| 第五月  (2/1~2/28) | 外層底片編輯實做 | 產出外層工作稿 |
| 第六月  (3/1~3/31) | 外層底片編輯實做 | 產出外層工作稿 |
| 第七月  (4/1~4/30) | 防焊底片編輯實做 | 產出防焊工作稿 |
| 第八月  (5/1~5/31) | 防焊底片編輯實做 | 產出防焊工作稿 |
| 第九月  (6/1~6/30) | 文字底片編輯實做 | 產出文字工作稿 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.Genesis 系統操作  2.PCB製程原理 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(6)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **客服實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.客訴處理  2.廠內外溝通協調能力培養  3. RMA 判定與開立  4.週、月報處理(廠內、客戶端)  5.參與客戶端會議預排版設計 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 7月  (7/4~7/29) | ●GCE公司組織/產品別介紹  ●PCB產品基礎認識  ●客服組織工作職責認識 | 了解GCE組職及PCB基礎流程，以及客服工作範疇及職責所在。 |
| ●PCB全製程簡略說明  ●設工介紹(front-end process)  ●製一簡介(內層->內檢)  ●Plant tour | 熟悉PCB基本流程，並了解前端製程基本概況及製造現場作業狀況。 |
| ●製二簡介(棕化壓合)  ●製二簡介(鑽孔)  ●Plant tour | 熟悉製造二部(壓合、鑽孔)的基本流程及作業方式。 |
| ●製二簡介(棕化壓合)  ●製二簡介(鑽孔)  ●Plant tour | 熟悉製造二部(壓合、鑽孔)的基本流程及作業方式。 |
| 8月  (8/1~8/29) | ●製三簡介(電鍍、外層乾膜、二銅)  ●Plant tour | 熟悉製造三部(PTH、外層覆膜、二銅)的基本流程及現場作業概況。 |
| ●製三簡介(電鍍、外層乾膜、二銅)  ●Plant tour | 熟悉製造三部(PTH、外層覆膜、二銅)的基本流程及現場作業概況。 |
| ●製三簡介(外層蝕刻、半檢)  ●Plant tour | 熟悉製造三部(外層蝕刻、外層半檢)的基本流程及現場作業概況。 |
| ●製四簡介(防焊、文字、表面處理)  ●Plant tour | 熟悉製造四部(防焊文字、表面處理)的基本流程及現場作業概況。 |
| 9月  (9/2~9/30) | ●製四簡介(成型、電測、修三、FQC)  ●Plant tour | 熟悉製造四部(成型、電、修三、OQC)的基本流程及現場作業概況。 |
| ●全廠Plant tour製程介紹練習(中文) | 具備全製程介紹的基本能力，可帶領客戶巡廠並介紹基本製程。 |
| ●全廠Plant tour製程介紹練習(英文) | 具備全製程介紹的基本能力，可帶領國外客戶巡廠並介紹基本製程。 |
| ●客服作業系統學習(Oracle/Mygce)  ●資訊系統學習(工單、WIP…)  ○實習訪談(確認實習生學習狀況) | 熟悉GCE資訊系統及客服作業使用系統，並訪談瞭解實習狀況，是情況調整後續實習排程 |
| 10月 (10/3~10/28) | ●異常現象學習(外觀、內/外層)  ●IPC規範學習  ●外觀維修學習(FQC) | 瞭解基礎PCB產品異常狀況/成因及IPC允收規範，並熟悉外觀不良維修方式。 |
| 11月、12月  (11/4~11/28)  (12/2~12/30) | ●外觀維修實戰(至客戶端實際覆判維修)  ○實習訪談(確認實習生學習狀況) | 瞭解客戶端作業概況並透過覆判維修實戰經驗瞭解客戶需求，將客戶需求傳遞廠內，培養內外部溝通協調能力。訪談瞭解實習生作業狀況，確認後續實習排程是否需進行調整。 |
| 1月、2月、3月  (1/2~1/30)  (2/3~2/27)  (3/3~3/31) | ●協助客訴處理(召開客訴會議/會議記錄/資料收集)以及客戶周月報更新。  ○實習訪談(確認實習生學習狀況) | 瞭解客訴會議召開模式，以及客訴處理SOP及相關資料收集方式，並熟悉國內外客戶別及例行工作(周月報)，培養內部溝通能力。 |
| 4月、5月、6月(4/3~4/28)  (5/1~5/29)  (6/2~6/30) | ●客訴處理實戰(例行客訴處理/主導客訴會議)  ○實習訪談(確認實習生學習狀況) -實習結訓- | 可獨立作業處理客訴專案、應對客戶需求問題、參與客戶周月會，具備完整溝通應答能力。 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.培養製作週/月報表，與滿足廠內/客戶端資料彙整需求的整合能力  2.與客戶信件往來，與客訴報告撰寫，養成商業書寫專業能力  3.可獨立完成客訴會議主持，與廠內/客戶端溝通協商的表達能力  4.完整具備客服工程師所需溝通協調與推動問題改善能力 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(7)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **可靠度實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.執行產品可靠度測試及問題分析  2.可靠度分析報告撰寫與彙整  3.實驗設備操作與維護  4.可靠度分析報告撰寫與彙整 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週  (9/1~9/8) | 1.熟悉環境  2.認識PCB製程  3.認識部門主管 | 了解金像製作流程及單位作業流程 |
| 第一月  (9/12~9/30) | 1.可靠度SOP G-QP-02產品可靠度試驗作業程序研讀  2.IPC-TM-650研讀 | 各項實驗程序差異結果彙整表 |
| 第二月  (10/3~10/31) | 實際依IPC-TM-650作業程序操作-part 1 | 各項實驗實際操作差異結果彙整表 |
| 第三月  (11/1~11/30) | 實際依IPC-TM-650作業程序操作-part 2 | 各項實驗實際操作差異結果彙整表 |
| 第四月  (12/1~12/30) | 失效分析資料閱讀及撰寫邏輯訓練 | 建立失效分析模版 |
| 第五月  (1/2~1/31) | 化金上鍚不良失效分析模版撰寫 | 化金上鍚不良失效分析模版建立 |
| 第六月  (2/1~2/28) | 實際操作分析化金上鍚不良案件 | 產出1份化金上鍚不良報告 |
| 第七月  (3/1~3/31) | ICD不良失效分析模版撰寫 | ICD不良失效分析模版建立 |
| 第八月  (4/3~4/28) | 實際操作分析ICD上鍚不良案件 | 產出1份ICD不良報告 |
| 第九月  (5/1~5/31) | 認證板報告模版撰寫 | 認證板報告模版建立 |
| 第十月  (6/1~6/30) | 學習成效心得報告 | 分享報告模版及IPC-TM650報告 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.完成2份失效分析模版建立  2.完成SOP及TM-650作業程序實際操作比對  3.完成認證板報告模版建立 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(8)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **PQE實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.異常處理  2.統計分析  3.專案進行 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週  (9/1~9/8) | 1.熟悉環境  2.認識PCB製程  3.認識部門主管 | 了解金像製作流程及單位作業流程 |
| 第一月  (9/12~9/30) | 製程介紹 | 工單流程、料號、批號等如何辨識 |
| 第二月  (10/3~10/31) | 檢驗規範介紹 | 檢驗項目、標準、手法、抽樣計劃 |
| 第三月  (11/1~11/30) | 資訊系統應用 | 品質管制系統、過帳管理系統、MYGCE簽核流程 |
| 第四月  (12/1~12/30) | 四功能訓練 | DRT報告 |
| 第五月  (1/2~1/31) | 基本功考核 | 基本功人員實作、筆試 |
| 第六月  (2/1~2/28) | 統計手法訓練、MECN檢定分析、SPC | 層別分析報告 |
| 第七月  (3/1~3/31) | MSA教育訓練 | 設備精度、準度、穩定性分析、Kappa |
| 第八月  (4/3~4/28) | 異常處理流程 | 產品處置、異常原因分析 |
| 第九月  (5/1~5/31) | 專案獨立訓練 | 結案報告 |
| 第十月  (6/1~6/30) | 學習成效心得報告 | 分享學習心得 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.能獨立進行基本功認證  2.熟悉MSA, SPC等手法, 可獨立處理異常  3.參與四功能運作, 能提出改善建議 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(9)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **大數據分析實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.資料收集  2.資料整理  3.資料分析與建模  4.協助模型上線 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週 | 1.了解金像環境及廠內各部門功能說明 | 了解各製程及各部門所在的位置 |
| 第二週 | 1.學習內層及壓合製程及其重要品質特性  2.連續型數據統計分析方法I | 了解內層、壓合input與output資料的關係 |
| 第三週 | 1.學習鑽孔及電鍍製程及其重要品質特性  2.連續型數據統計分析方法 II | 了解鑽孔、電鍍input與output資料的關係 |
| 第四週 | 1.學習外層及蝕刻製程及其重要品質特性  2.離散型數據統計分析方法I | 了解外層、蝕刻input與output資料的關係 |
| 第五週 | 1.學習防焊及文字製程及其重要品質特性  2.離散型數據分析方法II | 了解防焊、文字input與output資料的關係 |
| 第六週 | 1.學習成型及修三製程及其重要品質特性  2.量測系統分析與抽樣計劃 | 了解成型、修三input與output資料的關係 |
| 第七週 | 1.工單系統、WIP系統介紹  2.資料庫系統架構介紹 | 從資料庫取資料 |
| 第八週 | 1.自動化數據分析系統及報表分析系統  2.Python程式語言介紹 | 簡易分析與程式編輯 |
| 第九週 | 1.資料整理  2.資料分析 | 協助資料整理與分析工作 |
| 第十週起 | 1.上線作業 | 完成數據分析交辦工作 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.了解各製程的重要品質特性  2.協助收集與整理資料  3.協助完成資料分析、建立模型與發佈模型 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(10)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **程式開發實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.使用Fine Report報表工具參與資訊處專案的報表開發。 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週  (7/4-7/8) | 1.孰悉環境  2.認識部門主管  3.認識金像製程 | 了解金像組織及PCB基礎流程 |
| 第二週  (7/11-7/15) | 1.了解Fine Report功能  2.學習SQL查詢語句 | 依教材-掌握Fine Report工具基礎操作能力 |
| 第三週  (7/18-7/22) | 1.Fine Report入門課程學習 | 依教材-了解Fine Report功能及優勢，可以實現哪些效果，並通過視覺化展示和交互式的操作，直觀了解這些效果 |
| 第四週  (7/25-7/29) | 1.報表設計實戰練習 | 依教材-使用Fine Report工具設計報表 |
| 第五週  (8/1-8/5) | 1.專案人員說明進行中專案內容以及其需求。  2.製作報表分析文件並設計報表。 | 製作報表分析文件 |
| 第六週  (8/8-8/12) | 1.報表實作 | 報表製作進度報告 |
| 第七週  (8/15-8/19) | 1.報表實作 | 報表製作完成 |
| 第八週  (8/22-8/26) | 1.對使用單位發表報表操作使用 | 報表操作文件 |
| 第九週  (8/29-9/2) | 1.收斂學習成效、結訓心得報告 | 實習心得報告 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.了解如何從需求中設計一個報表。  2.學習Fine Report報表工具的應用。  3.於進行的專案中，參與報表開發。使用Fine Report報表工具，從需求分析中獨立開發一個報表並對使用者發表說明。 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(11)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **生產管理實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.生產進度安排  2.QTA 料號之啟動及追蹤  3.客戶訂單OTD管控  4.半成品WIP及成品庫存量管控  5.Surplus 管控 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一個月 | 1.環境認識  2.工作伙伴認識  3.PCB主要製程認識 | 1.熟悉公司環境及相關人員  2.熟悉PCB主要之製程 |
| 第二個月 | 發料及開立製令作業流程之認識及實際操作 | 操作發料程式及開立製令、發料單 |
| 第三個月 | 裁板、內層排程之認識及演練 | 能獨立完成裁板及內層之生產排程 |
| 第四個月 | 實際負責裁板及內層站之生產排程及追蹤進度 | 能掌握現場進度，若有異常能主動提出及管控 |
| 第五個月 | 實際負責裁板及內層站之生產排程及追蹤進度 | OTD 實際成績之掌控度 |
| 第六個月起 | 上線作業 | 完成生產排程任務 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.能夠獨立完成生管排程之安排。  2.能夠與現場單位溝通及協調。 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(12)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **測試工程**  **&維修工程師** | **此職務之緣由說明** | 1.機台保養/維修(保持穩定稼動)。  2.量產TROUBLE SHOOTING 。  3.重要料號跟催。  4.AOI DRT改善。  5.SOP/PMP/CHECKLIST制訂。  6.設備評估(架線)。  7.現場人員教育訓練。  8.開發導入新設備。 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 2月 | 1.熟悉環境  2.認識金像製程  3.認識部門主管/基本設備 | 瞭解PCB基礎流程  瞭解設備安全裝置功能和基本操作介面 |
| 3月 | 1.熟悉設備操作  2.熟悉SOP | 瞭解設備操作及PCB基礎流程 |
| 4月 | 1.熟悉設備操作  2.學習設備簡易設備故障排除  3.熟悉SOP | 瞭解設備操作及簡易設備故障排除 |
| 5月 | 1.熟悉設備操作  2.SOP/PMP/CL表單制定  3.DRT改善 | 瞭解設備操作及文件修改事項 |
| 6月 | 1.學習檢測設備操作及保養項目執行  2.學習SOP/PMP/CL/TPM  3.收斂學習成效、結訓心得報告 | 檢驗設備操作/SOP相關增修  實習心得報告 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.有獨立申請修改SOP系統操作能力  2.基本檢測設備、AOI設備維修能力 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(13)**  **職**  **務名**  **稱**  **：**  **設備維修**  **&廢水處理實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.PCB設備保養&維修  2.公共&廢水設備保養&維修  3.TPM執行&分析改善  4.PLC程式判讀與編輯  5.環保&工安相關預防工作檢查 | | |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 2月 | 1.熟悉環境&了解維護工作安全守則  2.熟悉備品料號建立規則及領料方式  3.熟悉廠內管路配置與標示方式 | 了解維護處組織,部門作業流程&工作安全意識 |
| 3月 | 1.認識廢水&空汙設備處理原理  2.了解十大工安專案項目與執行方式  3.學習塑料與金屬焊接 | 了解空汙,廢水處理方式&機械簡易維修 |
| 4月 | 1.認識氣壓與油壓控制原理  2.認識各種電控元件構造與原理  3.汙泥機操作與簡易維修 | 了解設備控制元件構造原理 |
| 5月 | 1.傳統電路符號判讀與電路設計  2.傳統電路配線  3.廢水水質分析&異常處理 | 學會傳統簡易控制迴路設計 |
| 6月 | 1.認識PLC&人機構造原理  2.認識PLC軟體,階梯圖與符號  3.PLC基本指令編輯 | 學會PLC簡易程式設計 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.具備基本自動控制專業知識  2.具備廢水處理能力  3.具備機械與管路焊接能力  4.了解PLC構造原理&基本指令判讀 | | |

**TPCA窗口:**03-3815659 曾乙玲#506 [lisa@tpca.org.tw](mailto:lisa@tpca.org.tw) ; 陽浩天#501 [keith@tpca.org.tw](mailto:keith@tpca.org.tw)

**《電路板產業實習媒合平台》**

**企業申請表-填寫說明**

1. **公司基本資料**

請填寫公司基本聯繫資料、與本專案之聯絡窗口人員(建議為人資部門先進)。

1. **公司招募訊息**
2. 公司介紹(必填)：介紹公司緣由、特色、主力產品(或服務)等資訊，以吸引學生在最短時間，可了解與掌握貴公司之訊息，以利來提升媒合成功之機率。
3. 薪資(必填)：可為時薪制或月薪制，並請符合政府法規所要求之最低薪資。
4. 保險(必填)：屆時需為學生投保勞保，若有其他保險福利也歡迎填寫告知。
5. 膳宿：如針對實習期間之餐飲、住宿、交通等項目，有提供實際支援或金額補助，也請填寫告知。
6. 其他福利：非上述1~4點，歡迎於此欄位新增填寫，以利提升媒合成功之機率。
7. 給實習生的招募說明：針對本實習職缺，對有意投此職務之學生所要做的招募說明，歡迎盡可能活潑生動，以利提升媒合成功之機率。
8. 未來若成為正職員工之其他福利：可於此提供與釋放公司更多的福利或前景資訊，來鼓勵實習學生，於實習結束後，積極於該企業繼續工作留用，成為正式員工。
9. **實習條件申請表**
10. 職務名稱(必填)：供校方轉達此資訊給學生，透過職稱對實習工作有概略認識。
11. 職務類型(必填)：供學生依照意願選擇職務類型，媒合過程中較不容易產生落差。
12. 部門(或產線) (必填)：讓學生針對工作部門(或產線)有概略認識，填寫清楚可避免實習開始後產生過大落差。
13. 地點(或廠區) (必填)：讓學生了解實習地點(或廠區)後，學生可針對工作地點進行篩選。
14. 主要工作(必填)：供校方轉達此資訊給學生，學生可以先行規劃是否符合未來志趣，避免雙方時間浪費。
15. 內容描述(必填)：供校方轉達此資訊給學生，請盡可能詳盡，以利校方在轉達時能更加完整說明，幫助學生釐清興趣。
16. 實習期間(可複選) (必填)：供校方轉達此資訊給學生，確認實習期間完全可以配合公司。
17. 所需人數(必填) ：供校方轉達此資訊給學生。
18. 時數與輪班(每周) (必填)：供校方轉達此資訊給學生，確認實習時數與輪班狀況完全可以配合公司。
19. 時數/天數(最低需求) (必填)：供校方轉達此資訊給學生，確認實習時數/天數完全可以配合公司。
20. 加班需求(必填)：供校方轉達此資訊給學生，學生可評估是否能接受實習期間的加班。
21. 希望校/系：供協會協助於期待的校系中進行媒合，或協助找尋相對合適的校系。
22. 英文能力：如有需要語言能力也請加註，將依照申請表上詳列需求項目進行合適人才挑選。
23. 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等)：供校方轉達此資訊給學生。
24. 其他需要檢附之資料：供校方轉達此資訊給學生。
25. 實習職缺屬性(必填)：供協會協助與校方溝通，並安排合適的實習對象。
26. 職缺有效期限(必填)：供協會協助於職缺有效性內進行媒合，同時也避免補進人力時，職缺已過時，故請協助填寫職缺有效期限。
27. **其他問題與建議**

針對TPCA本專案或其他產學合作之任何環節，或對未來可能媒合之學校、教授、學生，有任何疑問或建議，歡迎可於此欄位填寫。

1. **實習計畫書**(必填)
2. 職務名稱：請對應第三點之職務名稱
3. 此職務之緣由說明：說明企業為何設有此項職務，或是此項職務為何設定為本專案之實習職務。
4. 具體實習內容排程：請依據實習整體期間，各階段中的具體工作內容、方式，以及在各階段中，期待實習學生可獲得的能力與完成之項目。
5. 期待實習後可達成之目標：說明本職務在完成整個實習排程後，應該達成的工作能力或目標為何。

註：實際具體實習內容排程仍依照廠商工作安排做彈性調整

**TPCA窗口:**03-3815659 曾乙玲#506 [lisa@tpca.org.tw](mailto:lisa@tpca.org.tw) ; 陽浩天#501 [keith@tpca.org.tw](mailto:keith@tpca.org.tw)